ダイヤモンド中に存在する面欠陥に対し垂直な 回折面で撮影した 3D トポグラフ

|金沢大医薬保健 A,物質・材料機構 B,島根大理工 C 岡本博之^A, 中野智志^B, 森川公彦^C, 水野 薫^C

ダイヤモンドは工業用途や次世代半導体、超高圧実験用ダイヤモンドアンビルセル (DAC)等に対して多くの用途が有る。これらの用途に使用する場合、結晶の完全性評価 が重要となる。特に、超高圧実験用に使用されるダイヤモンドは、内部の格子欠陥の分布 がその耐圧強度を左右するため、事前に X 線トポグラフなどによる評価を行うことが望 ましいと考えられる。我々は以前の報告で、DAC 用ダイヤモンドの強度には結晶中に存 在する、ピラミッド形状、または屋根型形状をした面状欠陥が寄与している可能性を指摘 した。その面状欠陥は、{111} 上に存在しており積層欠陥の可能性が大きい。しかし、同 時に結晶中に存在する転位等の歪場の影響により、詳細な形状や、特定の回折面での消失 等、積層欠陥としての特性を評価することは難しい。そこで本実験では、観察された面状 欠陥が積層欠陥であることを確認するため、これと垂直な幾つかの回折面を使い、3次元 トポグラフを撮影した。

実験は高エネルギー加速器研究機構 PFの BL-20B で行った。シンテック製の DAC 用ダ イヤモンド(約2.0×2.0×1.5mm³)を試料とした。同試料は130GPaを加圧し、破損した 結晶である。単色X線を10µmのスリットにより整形して試料に照射した。回折面は面状 欠陥(1-11)と垂直な(2-4-6)、(044)、(4-2-6)、(-224)を用いた。それぞれ3次元トポグラフ を撮影した後、任意の面で切断して面状欠陥の形状を観察した。図1~4は、それぞれ回 折面を(2-4-6)、(044)、(4-2-6)、 (-224)として撮影した 3D ポグラフを(001)面と平行に、同 一の場所で切断した像である。図1、3、4に示すように(2-4-6)、(4-2-6)、(-224)を回折面 とすると、屋根型の面欠陥の一部を示す長方形の1辺(赤丸)が欠損して観察された。こ のとき欠損した面は(1-11)であった。また、図2に示すように(044)を回折面とすると、長 方形の2辺(赤丸)が欠損して観察された。このとき、欠損した面は(1-11)と(11-1)であっ た。

仮に、面状欠陥が特定の方向の歪場を持つ欠陥であれば、任意の方位で撮影した結果の いずれにおいても消滅する可能性は低い。つまり、天然ダイヤモンド中で観察される屋根 型の面状欠陥は、積層欠陥である可能性が高いと考えられる。



図1:回折面(2-4-6) 図2:回折面(044)







図3:回折面(4-2-6)

図4:回折面(-224)